

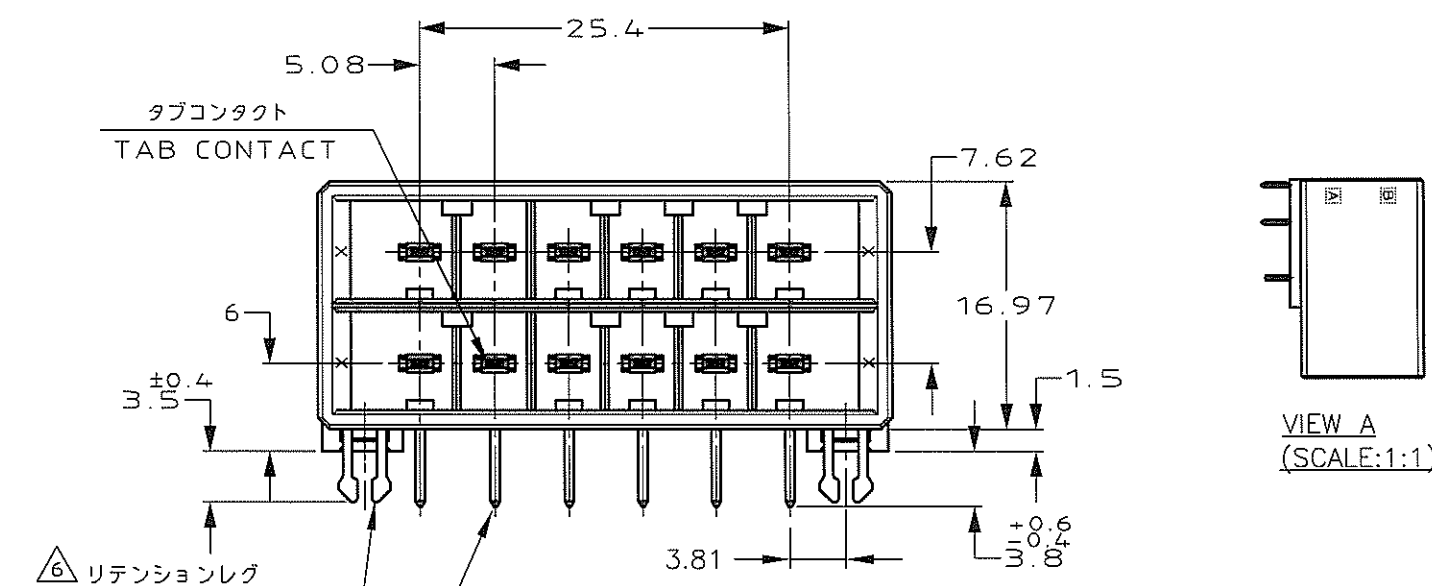
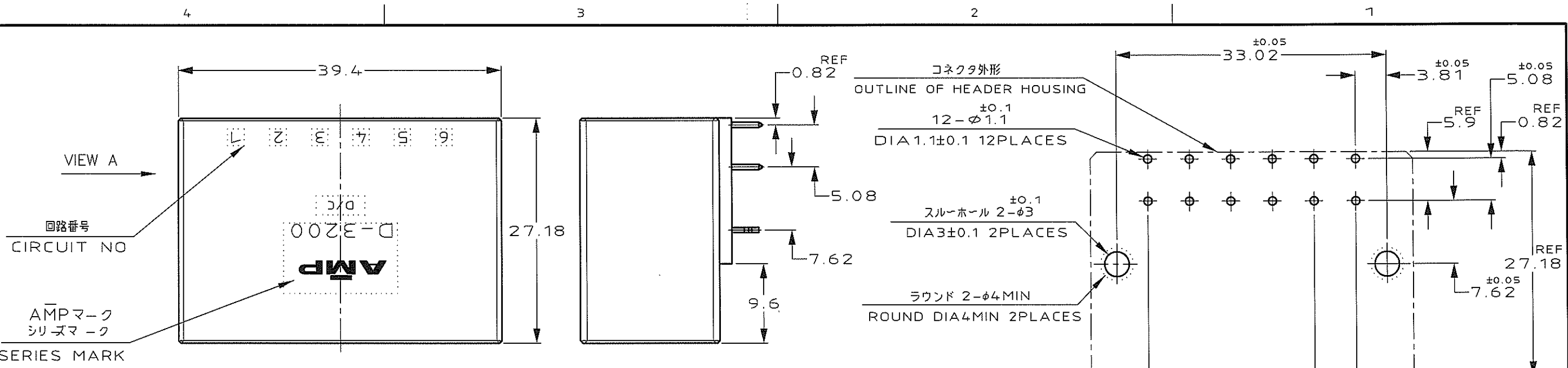
NUMBER 316081

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
 コンタクト: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金

△2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.38µm MIN金めっき

△3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.76µm MIN金めっき

△4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 µm MINスズめっき

△5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
 ニッケル下地の上に半田めっき

△6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY

△2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38µm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

△3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76µm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING

△4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 µm MIN TIN PLATED OVER NICKEL

△5. FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

△6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

△7. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

推奨基板取付け穴寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

KEYING LOCATION	A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.
B ROW	X	Y	△6 △4	3-316081-5	△7
A ROW			△6 △3	3-316081-3	
			△6 △2	3-316081-2	
B ROW	Y	Y	△6 △4	2-316081-5	
A ROW			△6 △3	2-316081-3	
			△6 △2	2-316081-2	
B ROW	X	X	△6 △4	1-316081-5	
A ROW			△6 △3	1-316081-3	
			△6 △2	1-316081-2	

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME	
mm#(AWG) -		mmφ		12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
DR. 4/JUL/95 K.IKEDA		DE. 4/JUL/95 K.IKEDA		SIZE	LOC
CHK. 4/JUL/95 Y.ISHIKAWA		APP. 4/JUL/95 S.MANABE		A3	J
LTR		REVISED PER ECO-11-005030		NUMBER	
DR		HMR		C-316081	
DATE		20MAR 11		SCALE	REV.
				2-1	B4
				SHEET	
				1 OF 1	

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>TE Connectivity\(泰科\)](#)